



# サーマルマネジメント研究会

## 2024年度第1回公開研究会

主催:サーマルマネジメント研究会

テーマ:ヒートパイプ技術の現状と将来展望

### ◆公開研究会のご案内

サーマルマネジメント研究会2024年度第1回公開研究会をハイブリッド開催致します。今回はヒートパイプ及びその関連技術にフォーカスし、日本ヒートパイプ協会ご協力のもと、4名の講師による講演で構成いたします。

開催日時 2024年10月30日 13:30~17:00

開催方式 現地開催&WEBハイブリッド(Zoom Webinarシステム利用)

開催場所:回路会館・地下1F会議室

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

### <本公開研究会の概要>

CPU/GPU、AI半導体を始めとする高発熱の先端半導体、モータ駆動や電源に使用されるパワー半導体では、冷却技術が小型・省エネ化を実現する重要な要素となっている。小スペースかつ高性能な冷却デバイスとして、ヒートパイプ及びその関連技術がある。これらは、コンピュータを始めとしてさまざまな機器に適用されているが、今もなお進化を続けている。本公開研究会では、ヒートパイプ及びその関連技術について、日本ヒートパイプ協会協力のもと、その動作原理や最新の技術動向について解説する。

13:30~13:40

オープニング

司会 サーマルマネジメント研究会 主査 西 剛伺(足利大学)

13:40~14:20

「ペーパーチャンバーを用いたサーバ用チップ冷却ユニットの開発」

(株)フジクラ 電子部品・コネクタ事業部門 電子部品開発部

サーマルテック開発グループ 萩野 春俊 氏

14:20~15:00

「ペーパーチャンバーを用いた高密度実装技術の新たな可能性」

(国研)産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門 主任研究員 馬場 宗明 氏

(休憩20分)

15:20~16:00

「ループヒートパイプの熱輸送原理とその利用先」

名古屋大学 未来社会創造機構 特任准教授 渡邊 紀志 氏

16:00~16:40

「次世代サーマルマネジメントを担う革新技術と冷却技術の新展開」

青山学院大学 理工学部機械創造工学科 教授 麓 耕二 氏

16:40~17:00

総合討論及びクロージング

司会及び講演者

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

次のような方におすすめです。

- ・電子機器の熱設計にこれから関わる方/既に関わっている方
- ・電子機器の小型化と熱設計の両立に困難を感じている方
- ・ヒートパイプ技術に興味をお持ちの方
- ・ヒートパイプ技術の近年の動向に興味をお持ちの方
- ・ヒートパイプの適用方法について興味をお持ちの方
- ・ヒートパイプの種類やその特性を学びたい方

#### 協賛団体

日本ヒートパイプ協会、公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会、公益社団法人 日本伝熱学会、  
一般社団法人日本電子回路工業会 (JPCA)

#### 参加要項

定員 回路会館・地下1F会議室:50名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)  
WEB (Zoom Webinar): 100名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員・賛助会員:5,000円、協賛団体会員:5,000円、学生会員:1,000円、  
研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円、名誉会員:無料、非会員一般:10,000円、  
非会員学生:2,000円

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

#### 注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。  
(お支払い方法:クレジットカード決済・コンビニ決済)(手数料学会負担)
- ③**領収書(宛名会社名選択可)**のご発行は、返信メールのマイページから**決済後に即日出力が可能**です。
- ④WEBの領収書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。

\*キャンセルポリシー

お申込み後のキャンセルはできません。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会  
E-mail: info@jiep.or.jp  
(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)